

- 8:45 Anmeldung
- 9:00 Informationen zur Ablauforganisation
- 9:15 Eröffnung durch Dr. Robin Schulze, SITEC Industrietechnologie GmbH

## Key-Note-Vorträge

- 9:30 *Mechatronische Komponenten und deren Anwendung in Hydrogelen*, Prof. Dr. Gerlach, TU Dresden
- 10:00 *Kombination von flexibler Elektronik und mechatronischen Systemen*, Dr. Gronarz, Organic Electronics Saxony e.V.
- 10:30 *Advances in numerical simulations of automotive electronics*, P. Jakub Gromala, Robert Bosch GmbH
- 11:00 Q&A

11:15 Pause (15min)

## Kurzdarstellung der AllMeSa Verbundprojekte

- 11:30 *Neuartige Herstellungs- und Prüftechnologien für MEMS – Druckzellenwandler*, Benjamin Reichelt, XENON Automatisierungstechnik GmbH
- 11:40 *Neuartige Druckzellen-Strukturierung mittels Laserbearbeitung*, Gert Springer, i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH
- 11:50 *Glassensorik für die Brennstoffzelle*, Uwe Beier, Adenso Industrial Services GmbH

12:00 Pause (60min)

## AllMeSa-Vorträge in Parallel-Sessions

13:00-14:45

Session 1	Session 2	Session 3
<p><b>Neuartige Herstellungs- und Prüftechnologien für MEMS – Druckzellenwandler</b></p> <p>13:00 <i>Entwicklung von automatisierten Fertigungsprozessen für die Herstellung eines Sensor-Subassembly – Schwerpunkt: Handlingssysteme</i>, Benjamin Reichelt, XENON Automatisierungstechnik GmbH</p> <p>13:15 <i>Entwicklung eines mittels reaktivem Fügen produzierbaren Drucktransmitters mit MEMS-Druckzelle (Produktdemonstrator)</i>, Dr. Karsten Sager, i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH</p> <p>13:30 <i>Entwicklung von Kontaktierungs- und Prüftechnologien für reaktiv gefertigte MEMS – Druckzellen</i>, Prof. Bernd Hommel, ITW e.V. Chemnitz</p>	<p><b>Neuartige Druckzellen-Strukturierung mittels Laserbearbeitung</b></p> <p>13:00 <i>Entwicklung eines Druckmessdemonstrators mittels Laserstrukturierter Edelmetallmembran, Druckzellen und Zuverlässigkeitsuntersuchungen</i>, Gert Springer, i2s Intelligente Sensorsysteme Dresden GmbH</p> <p>13:15 <i>Technologische Analysen für die Entwicklung neuer Dünnschicht-Drucksensoren</i>, Dr. Karsten Meier, TU Dresden, IAVT-Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik</p> <p>13:30 Q&amp;A Teil 1</p>	<p><b>Glassensorik im Energiewandler SOC (Solid Oxide Stack)</b></p> <p>13:00 <i>Rolle-zu-Rolle-Verfahren zur Fertigung biegsamer Glas-Sensorik für einen breiten Temperaturbereich</i>, Uwe Beier, Adenso Industrial Services GmbH</p> <p>13:15 <i>Technologiebewertung und Anlagenkonzepte zur Bearbeitung ultradünner Glassubstrate (UTG) mittels Laser</i>, Dr. Robin Schulze, SITEC Industrietechnologie GmbH</p> <p>13:30 <i>Optimierter SOC-Energiewandler mit integrierter Glas-Sensorik</i>, Dr. Ludwig Reichel, sunfire GmbH</p>
<p>13:45 Pause (15min)</p> <p>14:00 <i>Entwicklung von reaktiven Pasten zum Fügen von Materialien</i>, Lukas Stepien, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden</p> <p>14:15 <i>Entwicklung eines cloudbasierten Produktionssteuerungssystems</i>, Thomas Dreyer, Kontron AIS GmbH</p> <p>14:30 Q&amp;A</p>	<p>14:00 <i>Technologieuntersuchung zur laserbasierten Strukturierung von Druckmesszellen-Membranen</i>, Dominique Schubert, SITEC Industrietechnologie GmbH</p> <p>14:15 <i>Entwicklung von automatisierten Fertigungsprozessen für die Herstellung von laserstrukturierten Edelmetall-Druckmesszellen</i>, Benjamin Reichelt, XENON Automatisierungstechnik GmbH</p> <p>14:30 Q&amp;A Teil 2</p>	<p>14:00 <i>Reaktives Löten von Glassubstraten auf Basis reaktiver Folien</i>, Prof. Bernd Hommel, ITW e.V. Chemnitz</p> <p>14:15 <i>Technologieentwicklung für hochtemperaturfähige Elektronik auf dünnen Glassubstraten</i>, Philip Knoch, TU Dresden, IAVT- Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik</p> <p>14:30 Q&amp;A</p>
<p>14:45 Pause (15min)</p>		

## Key-Note-Vorträge

- 15:00 *Zukünftige Softwarelösungen für Maschinenumrüstungen - ohne spezielle Programmierkenntnisse*, Dr. Neubert, HYDRIVE Engineering GmbH
- 15:30 *Advanced High Density Rigid Packaging Substrates for RF and Miniaturization*, Daniel Schulze, Dyconex AG
- 16:00 *Trägersubstrate aus Biopolymeren für Elektronikanwendungen?*, Prof. Bauer, HTW Dresden
- 16:30 Q&A

16:45 Ausblick und Zusammenfassung